



RE460

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Distancias entre los agujeros de la trama de 0,50 mm - 1,27 mm
- Diámetro de agujero 1,00 mm
- Placa de circuito impreso de adaptación para 23 distintas SMD-IC's
- Puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- Soldadura manual: para el tratamiento individual SMD en e sector de laboratorio es posible una aplicación a pulso de 100 - 200 puntos individuales con dosificadores de precisión con medidas de trama de 0,50 mm - 1,27 mm
- Soldadura "Reflow" mediante plantillas SMD separadas y fabricadas especialmente
- Tamaño 120 x 175 mm

Módulo-No.	Pitch	Pin
RE460-01	0,800 mm	QFP 32, 80
	0,500 mm	QFP 64
RE460-02	0,800 mm	QFP 80
	0,650 mm	QFP 100
RE460-03	0,650 mm	QFP 80, 84
RE460-04	0,650 mm	QFP 144, 160
	0,635 mm	QFP 100, 132, 164
RE460-05	1,270 mm	PLCC 32, 52, 68, 84
	0,635 mm	QFP 100
	0,500 mm	QFP 100
RE460-06	1,270 mm	PLCC 28, 44
	0,800 mm	QFP 44
RE460-07	1,270 mm	PLCC 18
RE460-08	1,270 mm	PLCC 20
RE460-09	1,270 mm	PLCC-Eprom 32